

RX64M/RX71M グループ

RX64M/RX71M グループの高温動作に関する注意事項

要旨

本書では、高温動作に対応したGバージョン製品における代表的な高温アプリケーション事例に対するディレーティング例、注意事項を示します。

目次

1. RX ファミリの実使用環境と信頼性の関係	2
1.1 MCUにおける信頼性の考え方	2
1.2 ディレーティングについて	2
2. 熱特性定義	3
3. 熱設計	4
3.1 T _j 算出例	4
3.1.1 消費電力 Pd から T _j を算出	4
3.1.2 パッケージトップ中央の温度 T _t から T _j を算出	4
3.1.3 T _t 測定における注意事項	5
3.2 熱特性パラメータ	6
3.2.1 RX64M グループ 熱特性パラメータ	6
3.2.2 RX71M グループ 熱特性パラメータ	6
3.3 消費電力 (Pd) の算出方法	7
4. 代表的な高温アプリケーションにおけるディレーティング例	10
5. 参考ドキュメント	12
改訂記録	13

1. RX ファミリの実使用環境と信頼性の関係

1.1 MCU における信頼性の考え方

RX ファミリの MCU をご使用になる場合、デバイスの信頼性を確保する為に以下に示す注意事項を守るようお願いいたします。

半導体デバイスの信頼性は、故障率曲線（バスタブカーブ）で表現されます。デバイスの使用（稼動）開始後、比較的早い時期に発生する初期故障に、その後長い使用期間にわたって発生する偶発故障、デバイスの本質的寿命にともなって時間とともに増加する摩耗故障（耐用寿命）の3領域に分けられます。バスタブカーブの詳細については信頼性ハンドブック Rev. 2.50（R51ZZ0001JJ0250）をご参照ください。

この中で摩耗故障は半導体デバイスが使用される温度環境に大きく依存します。MCU が摩耗故障に至らないようにするためディレーティングの考え方が重要です。

1.2 ディレーティングについて

ディレーティングとは、『信頼性を改善するために、計画的に負荷を定格値から軽減すること』と JIS Z8115 で定義されています。

半導体デバイスの品質、信頼性は、使用環境に大きく左右されます。すなわち、同じ品質の製品でも使用環境が厳しくなると信頼性が低下し、使用環境が緩くなると信頼性が向上します。たとえ最大定格内であっても、寿命試験に相当するような非常に厳しい条件での使用になりますと、摩耗的な故障の原因になる可能性もありますので、ディレーティングの考え方は非常に重要です。

ディレーティングは一般に、ディスクリートやパワーIC など、使用条件範囲が広い上、特に発熱の問題から使用範囲内（例えば電圧）であっても、発生電力、周囲温度、使用ヒートシンクの特性の関係からジャンクション温度への配慮が必要で相互に関係する周囲温度、接合温度、電圧、電流、電力などの使用条件間で調整が必要な製品群に適用されます。

ディレーティングに関する詳細は信頼性ハンドブック Rev. 2.50（R51ZZ0001JJ0250）の「5.2.3 ディレーティングについて」をご参照ください。

本アプリケーションノートでは、代表的な高温アプリケーションで想定される温度プロファイルと、本製品グループで対応可能なディレーティング例を示します。

2. 熱特性定義

熱特性定義は、以下に示す JEDEC 仕様にに基づいています。詳細については次の URL を参照してください。

<https://www.renesas.com/jp/ja/support/technical-resources/packaging/characteristic/heat-dissipation>

表 2.1 IC 系 熱特性定義

θja	定義	実装ボードにパッケージを搭載した時の、ジャンクション温度 (Tj) と周囲温度 (Ta) 間の熱抵抗。自然対流のみの場合と強制空冷を想定した場合の 2 種類の環境が存在
	用途	異なるパッケージ間での放熱性能の比較
ψjt	定義	デバイス全体の消費電力 (Pd) に対する、ジャンクション温度 (Tj) とパッケージトップ中央の温度 (Tt) の温度差を表す熱特性パラメータ。
	用途	適切な環境で算出された ψjt と Tt、Pd より、ジャンクション温度 (Tj) を推定

Ta : 発熱源の影響を受けない場所の温度

熱特性	θja	ψjt
環境		
	<ul style="list-style-type: none"> 筐体 : 304.8 × 304.8 × 304.8mm (JESD51-2 準拠) 実装基板 : 40mm□以下の BGA⇒101.6 × 114.3 × t1.6mm、4 層 (JESD51-9 準拠) 27mm□以上の QFP⇒101.6 × 114.3 × t1.6mm、4 層 (JESD51-7 準拠) 27mm□未満の QFP⇒76.2 × 114.3 × t1.6mm、4 層 (JESD51-7 準拠) 	
定義式	$\theta_{ja} = \frac{T_j - T_a}{P_d}$	$\psi_{jt} = \frac{T_j - T_t}{P_d}$

3. 熱設計

一般的に半導体素子の接合温度（ジャンクション温度）は、半導体の寿命に影響を与え、温度によっては破壊する可能性があります。そのため、消費電力の大きいシステム LSI ではジャンクション温度（Tj）が規定され、許容温度内で動作するように熱設計を行う必要があります。

ご使用環境でジャンクション温度（Tj）の許容温度に近いまたは超えるような場合は、ジャンクション温度の推定を行ってください。お客様のユースケースでの Tj を算出いただくことで、電気的特性のジャンクション温度の最大値以下あることを確認し、もし結果が最大値を超えている場合には、部品レイアウト、筐体構造、消費電力の見直しを行ってください。

ジャンクション温度（Tj）は直接測定出来ませんので、消費電力、または表面温度から、熱特性パラメータを使用して算出する必要があります。本ガイドでは Tj 算出として 2 つの例を示します。

3.1 Tj 算出例

3.1.1 消費電力 Pd から Tj を算出

周囲温度（Ta）および熱抵抗 θ_{ja} を使用して、下記式からジャンクション温度（Tj）を推定し Tj が 125°C 以下である事を確認してください。 θ_{ja} は使用環境（実装基板や筐体）により大きく変わるため、十分にマージンを取った熱設計を行ってください。本計算式は試作前の見積もりをターゲットにしており、最終的に実使用環境下で実機確認をお願い致します。

$$Tj = Ta + Pd \times \theta_{ja}$$

Tj：ジャンクション温度 [°C]

Ta：LSI パッケージ（筐体内）の周辺温度 [°C]

Pd：LSI 全体の消費電力 [W]

θ_{ja} ：ジャンクション温度（Tj）と周囲温度（Ta）間の熱抵抗 [°C/W]

注 1. Pd は「3.3 章 消費電力（Pd）の算出方法」を参照してください。

注 2. θ_{ja} は「3.2 章 熱特性パラメータ」を参照してください。

3.1.2 パッケージトップ中央の温度 Tt から Tj を算出

ご使用環境における、パッケージトップ中央の温度（Tt）および LSI 全体の消費電力（P）を測定し、下記式からジャンクション温度（Tj）を算出します。

$$Tj = Tt + Pd \times \psi_{jt}$$

Tj：ジャンクション温度 [°C]

Tt：パッケージトップ中央の温度 [°C]

Pd：LSI 全体の消費電力 [W]

ψ_{jt} ：ジャンクション温度（Tj）からパッケージトップ中央までの熱特性パラメータ [°C/W]

注 1. Pd は「3.3 章 消費電力（Pd）の算出方法」を参照してください。

注 2. ψ_{jt} は「3.2 章 熱特性パラメータ」を参照してください。

仮にジャンクション温度（Tj）が 125°C を超えた場合、必要に応じて部品レイアウト、筐体構造、消費電力の見直し等を行ってください。

3.1.3 Tt 測定における注意事項

- 熱電対を使用した測定
温度を正確に測定するため、使用する熱電対および測定対象への熱電対の取り付け方にご注意下さい。
注意点と推奨は下記です。
 - 熱電対はできるだけ線径の細いものを使用して下さい（熱引き抑制のため。推奨：直径 150um 以下）
 - 熱電対は K 型を推奨します（T 型は熱電対での放熱が大きく、温度を低く測定する可能性があります）
 - 熱電対の固定には耐熱樹脂テープもしくは耐熱樹脂材を推奨します
 - 熱電対は測定対象にしっかりと固定して下さい（“浮き”があると測定誤差を生じます）
- 測定ポイント
温度が飽和状態に達していることを確認して、パッケージ上面中央で Tt を測定してください。
- サーモグラフィ（サーモカメラ）を使用した測定
温度を正確に測定するため、サーモグラフィに測定対象の放射率を設定して下さい。ボード表面の放射率はおおよそ 0.8~0.9 ですが、金属表面は一般に小さな値になります。（金属表面を 0.8~0.9 設定で測定すると実際の温度より低く測定することになります）。放射率が不明の場合は、黒体スプレーなどで表面処理を行い、黒体スプレーの放射率を設定すると温度を正しく測定することができるようになります。
また、サーモグラフィと測定対象の間に物があると（透明のアクリル板であっても）正しい測定結果が得られないのでご注意ください。（この場合、サーモグラフィはアクリル板の温度を測定します）
サーモグラフィによる温度測定は、測定対象の配置状況により難しい場合もありますが、温度分布を知るには有効な手段ですので、熱電対と併用することをお勧めします。

3.2 熱特性パラメータ

3.2.1 RX64M グループ 熱特性パラメータ

RX64M グループの熱特性パラメータを下記に示します。

表 3.1 RX64M グループ熱特性パラメータ

パッケージ	実装基板層数	θ_{ja} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]	ψ_{jt} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]
176 ピン LQFP PLQFP0176KB-A	4 層	39.4	0.5
144 ピン LQFP PLQFP0144KA-A	4 層	40.7	0.5
100 ピン LQFP PLQFP0100KB-A	4 層	41.7	0.5

注. これらの値は EIA/JEDEC 規格に定められた測定環境で算出しています。環境の詳細については、EIA/JEDEC 規格（JESD51-2 および JESD51-7 準拠）を参照してください。

3.2.2 RX71M グループ 熱特性パラメータ

RX71M グループの熱特性パラメータを下記に示します。

表 3.2 RX71M グループ熱特性パラメータ

パッケージ	実装基板層数	θ_{ja} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]	ψ_{jt} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]
176 ピン LQFP PLQFP0176KB-A	4 層	39.1	0.5
144 ピン LQFP PLQFP0144KA-A	4 層	40.4	0.5
100 ピン LQFP PLQFP0100KB-A	4 層	41.3	0.5

注. これらの値は EIA/JEDEC 規格に定められた測定環境で算出しています。環境の詳細については、EIA/JEDEC 規格（JESD51-2 および JESD51-7 準拠）を参照してください。

3.3 消費電力 (Pd) の算出方法

消費電力 (Pd) は以下の式で求められます。

$$\text{消費電力} = \text{電圧} \times \text{電流} + \sum \{ (\text{VOL} \times \text{IOL}) \} + \sum \{ (\text{VCC} - \text{VOH}) \times | -\text{IOH} | \} \quad \text{—————①}$$

図 3.1 に電流パスの構成図を示します。電流は DC 電流と AC 電流で、以下の式となります。

$$\text{DC 電流} = \text{リーク電流} + \text{アナログ電流} \quad \text{—————②}$$

$$\text{AC 電流} = \text{ロジック電流} + \sum \text{IO_AC 電流} \quad \text{—————③}$$

$\sum \text{IO_AC}$ 電流は、ご使用する IO の本数、容量 (入力端子容量^{注1}、外部負荷容量)、および端子のスイッチング周波数から、以下の式となります。

$$\sum \text{IO_AC 電流} = \sum (\text{入力端子容量} + \text{外部負荷容量}) \times \text{スイッチング周波数} \times \text{VCC} \quad \text{—————④}$$

注 1. 入力端子容量 (Cin) は、各製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編「64. 電気的特性」の DC 特性を参照してください。

リーク電流、アナログ電流、およびロジック電流は、表 3.3 RX64M 消費電流内訳、表 3.4 RX71M 消費電流内訳から算出してください。また、ロジック電流は AC 電流になりますので、単位電流 (mA/MHz) に動作周波数 (MHz) を掛けて算出してください。

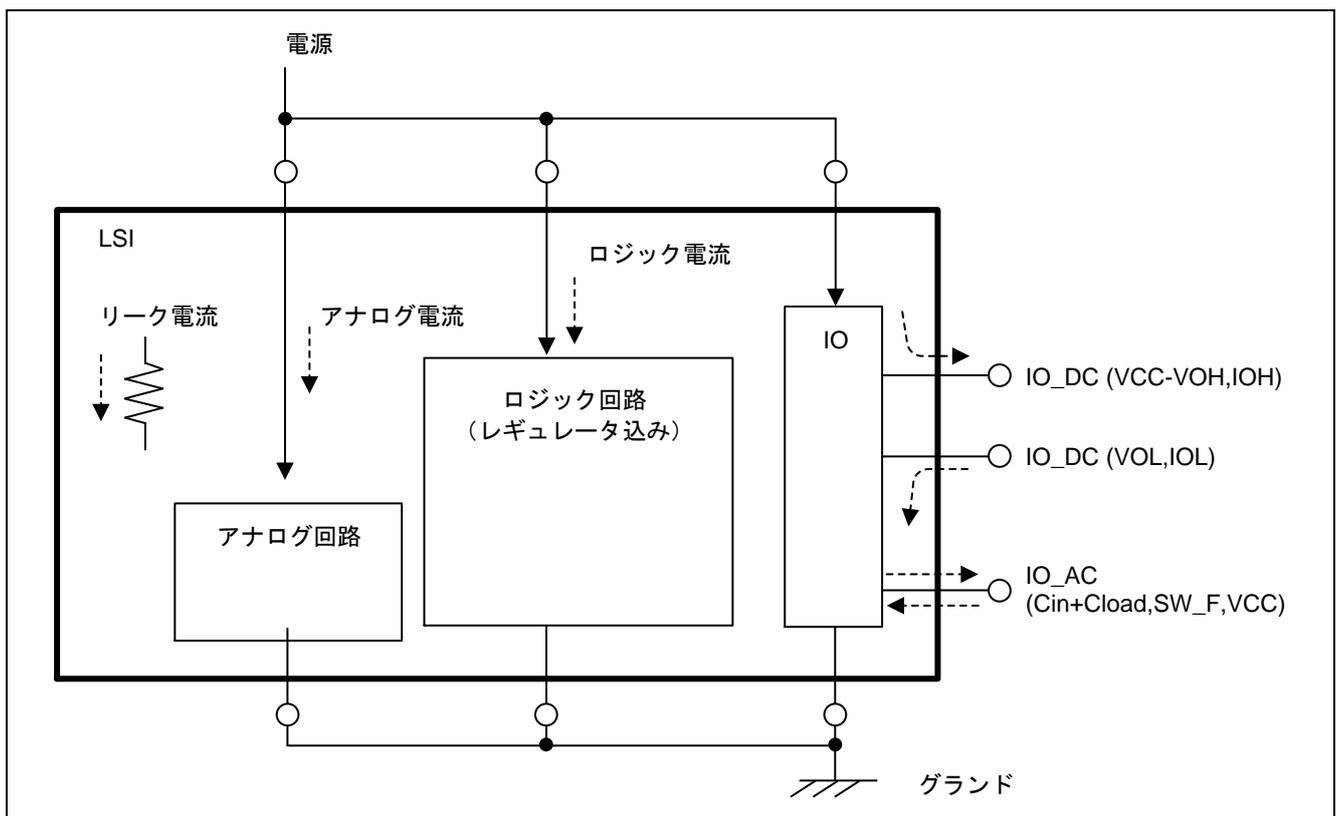


図 3.1 電流パスの構成図

表 3.3 RX64M 消費電流内訳

No	種類	大項目	中項目	小項目	周波数 [MHz]	単位電流 [mA/MHz] 注2	最大電流 [mA] 注1	備考	
1	DC	リーク			—	—	27.00		
2			アナログ	USBb		—	—	10.00	
3				USBA		—	—	20.00	PHYSET.HSEB=0
4				S12ADC (unit0+チャンネル専用 S&H)		—	—	2.62	
5				S12ADC (unit1+TEMPS)		—	—	1.10	
6				R12DA		—	—	1.40	
7	AC	ロジック	CPU	CoreMark 動作	120	0.225	27.00		
8			周辺 IP	DMACAa / DTCa		0.023	2.76		
9				MTU3a		0.025	3.00		
10			GPTA			0.021	2.52		
11			ETHER (EDMACa 含む)			0.121	14.52	1ch 分の値 注3	
12			EPTPC			0.071	8.52		
13			USBA		0.013	1.56			
14			SCIFA		0.002	0.24	1ch 分の値 注3		
15			RSPIa		0.004	0.48			
16			AES		0.018	2.16			
17			EXDMACA		60	0.007	0.42		
18			TPUa			0.004	0.24		
19			RTCd, WDTA, IWDTa			0.007	0.42	1unit 分の値 注4	
20			CMT, CMTW, TMRb			0.003	0.18	1unit 分の値 注4	
21			POE3a, PPG			0.002	0.12	1unit 分の値 注4	
22			USBb			0.011	0.66		
23			SCIg			0.003	0.18	1ch 分の値 注3	
24			SCIh			0.003	0.18		
25			RIICa			0.002	0.12	1ch 分の値 注3	
26			CAN			0.005	0.30	1ch 分の値 注3	
27			QSPI			0.003	0.18		
28			SSI			0.002	0.12	1ch 分の値 注3	
29			SRC			0.027	1.62		
30			SDHI			0.012	0.72		
31			MMCIF		0.014	0.84			
32			PDC		0.002	0.12			
33			DES		0.005	0.30			
34			SHA		0.021	1.26			
35			RNG		0.006	0.36			
36			S12ADC, TEMPS		0.009	0.54	1unit 分の値 注4		
37			R12DA		0.002	0.12			
38			DOC, CAC, CRC		0.003	0.18	1unit 分の値 注4		
39	ELC		0.005	0.30					

注1. ワorst条件 (VCC=3.6V、Tj=125°C) です。

注2. AC に関する単位電流は、VCC の値に依存しません。

注3. 使用するチャンネル数分電流値を積算してください。

注4. 使用するモジュールごとのユニット数分電流値を積算してください。

表 3.4 RX71M 消費電流内訳

No	種類	大項目	中項目	小項目	周波数 [MHz]	単位電流 [mA/MHz] 注2	最大電流 [mA] 注1	備考	
1	DC	リーク			—	—	137.00		
2		アナログ	USBb		—	—	10.00		
3			USB ^{※3}	USB2.0 FS		—	—	22.00	PHYSET.HSEB=0
4				USB2.0 HS		—	—	65.00	PHYSET.HSEB=0
5			S12ADC (unit0+チャンネル専用 S&H)		—	—	—	3.42	
6			S12ADC (unit1+TEMPS)		—	—	—	2.30	
7			R12DA		—	—	—	1.40	
8	AC	ロジック	CPU	CoreMark 動作	240	0.210	50.40		
9			周辺 IP	DMACa / DTCa			0.023	5.52	
10				MTU3a		120	0.025	3.00	
11				GPTA			0.021	2.52	
12				ETHERC (EDMACa 含む)			0.115	13.80	1ch 分の値 注4
13				EPTPCa			0.051	6.12	
14				USBA			0.009	1.08	
15				SCIFA			0.002	0.24	1ch 分の値 注4
16				RSPIa			0.004	0.48	1ch 分の値 注4
17				AESa			0.023	2.76	
18				EXDMACa		60	0.003	0.18	
19				TPUa			0.004	0.24	
20				RTCd, WDTA, IWDTa			0.003	0.18	1unit 分の値 注5
21				CMT, CMTW, TMRb			0.003	0.18	1unit 分の値 注5
22				POE3a, PPG			0.002	0.12	1unit 分の値 注5
23				USBb			0.011	0.66	
24				SCIg			0.003	0.18	1ch 分の値 注4
25				SCIh			0.003	0.18	
26				RIICa			0.002	0.12	1ch 分の値 注4
27				CAN			0.004	0.24	1ch 分の値 注4
28				QSPI			0.003	0.18	
29				SSI			0.002	0.12	1ch 分の値 注4
30				SRC			0.022	1.32	
31				SDHI			0.009	0.54	
32				MMCIF			0.012	0.72	
33				PDC			0.002	0.12	
34				DES			0.005	0.30	
35				SHAa			0.015	0.90	
36				RNG			0.006	0.36	
37				S12ADC, TEMPS			0.005	0.30	1unit 分の値 注5
38				R12DA			0.002	0.12	
39				DOC, CAC, CRC			0.002	0.12	1unit 分の値 注5
40				ELC			0.003	0.18	

注1. ワースト条件 (VCC=3.6V、Tj=125°C) です。

注2. AC に関する単位電流は、VCC の値に依存しません。

注3. ご使用の動作モードでどちらかを選択してください。

注4. 使用するチャンネル数分電流値を積算してください。

注5. 使用するモジュールごとのユニット数分電流値を積算してください。

4. 代表的な高温度アプリケーションにおけるディレーティング例

表 4.1 に代表的な RX64M/RX71M グループの高温度アプリケーションの想定される温度プロファイルとディレーティングのための推奨温度プロファイルを示します。推奨温度プロファイルは、信頼性試験結果から見積もったものです。

対象品の型名は、表 4.2 対象製品型名 (RX64M グループ)、および表 4.3 対象製品型名 (RX71M グループ) を参照してください。

事例 5 とケース 2 の事例 6、7、8 を除き、ディレーティングは 10 年間で想定しています。

お客様の使用条件に近い例をお選びください。もし、適当な例がない場合は、個別に問い合わせをお願いします。なお、ケース 2 は温度プロファイルの動作時間を半分にして、温度を上げています。

表 4.1 代表的な高温度アプリケーション

事例	アプリケーション	想定される温度プロファイル	ディレーティングのための推奨温度プロファイル	
			ケース 1	ケース 2
1	調理器具 (Cook Top、IH 他)	高温環境で 3hrs/day の動作 時間 その他の時間はスタンバイ or 停止	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 112^{\circ}\text{C}$ 3 hrs/day その他時間は $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 90^{\circ}\text{C}$ でスタンバイ or 停止	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 125^{\circ}\text{C}$ 1.5 hrs/day その他時間は $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 90^{\circ}\text{C}$ でスタンバイ or 停止
2	家電モータ、 電動工具、他	高温環境での使用が 6hrs/day その他の時間はスタンバイ or 停止	$102^{\circ}\text{C} < T_j \leq 112^{\circ}\text{C}$ 3 hrs/day $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 102^{\circ}\text{C}$ 3 hrs/day その他時間は $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 90^{\circ}\text{C}$ でスタンバイ or 停止	$115^{\circ}\text{C} < T_j \leq 125^{\circ}\text{C}$ 1.5 hrs/day $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 115^{\circ}\text{C}$ 1.5 hrs/day その他時間は $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 90^{\circ}\text{C}$ でスタンバイ or 停止
3	EV 充電器等	高温環境での使用が 8hrs/day その他の時間はスタンバイ or 停止	$102^{\circ}\text{C} < T_j \leq 112^{\circ}\text{C}$ 4 hrs/day $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 102^{\circ}\text{C}$ 4 hrs/day その他時間は $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 85^{\circ}\text{C}$ でスタンバイ or 停止	$115^{\circ}\text{C} < T_j \leq 125^{\circ}\text{C}$ 2 hrs/day $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 115^{\circ}\text{C}$ 2 hrs/day その他時間は $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 85^{\circ}\text{C}$ でスタンバイ or 停止
4	スマートメータ、 パワコン等、 屋外へ設置する機器等 (24 時間駆動)	高温環境での使用が 8hrs/day その他の時間も動作	$102^{\circ}\text{C} < T_j \leq 112^{\circ}\text{C}$ 4 hrs/day $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 102^{\circ}\text{C}$ 4 hrs/day $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 87^{\circ}\text{C}$ その他時間	$115^{\circ}\text{C} < T_j \leq 125^{\circ}\text{C}$ 2 hrs/day $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 115^{\circ}\text{C}$ 2 hrs/day $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 100^{\circ}\text{C}$ その他時間
5	PC サーバ電源等 (24 時間駆動)	高温を含む環境で連続 5 年使用	$102^{\circ}\text{C} < T_j \leq 112^{\circ}\text{C}$ 15,000 hrs $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 102^{\circ}\text{C}$ 30,000 hrs 連続 5 年使用	$115^{\circ}\text{C} < T_j \leq 125^{\circ}\text{C}$ 7,500 hrs $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 115^{\circ}\text{C}$ 15,000 hrs 連続 2.5 年使用
6	産業モータ (24 時間駆動：例 1)	高温環境で連続使用	$89^{\circ}\text{C} < T_j \leq 99^{\circ}\text{C}$ 80% $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 89^{\circ}\text{C}$ 20%	$102^{\circ}\text{C} < T_j \leq 112^{\circ}\text{C}$ 80% $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 102^{\circ}\text{C}$ 20% 連続 5 年使用
7	産業モータ (24 時間駆動：例 2)	厳しい高温を含む環境で連続 使用	$97^{\circ}\text{C} < T_j \leq 112^{\circ}\text{C}$ 5% $92^{\circ}\text{C} < T_j \leq 97^{\circ}\text{C}$ 75% $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 92^{\circ}\text{C}$ 20%	$110^{\circ}\text{C} < T_j \leq 125^{\circ}\text{C}$ 5% $105^{\circ}\text{C} < T_j \leq 110^{\circ}\text{C}$ 75% $-40^{\circ}\text{C} \leq T_j \leq 105^{\circ}\text{C}$ 20% 連続 5 年使用
8	産業モータ (24 時間駆動：例 3)	高温環境で連続使用	$T_j \leq 97^{\circ}\text{C}$ 100%	$T_j \leq 116^{\circ}\text{C}$ 100% 連続 5 年使用

注. 周囲温度 (T_a) は、 $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ 以内でご使用してください。

表 4.2 対象製品型名 (RX64M グループ)

対象製品型名	パッケージ	対象製品型名	パッケージ	対象製品型名	パッケージ
R5F564MFCGFP	LQFP100	R5F564MFCGFB	LQFP144	R5F564MFCGFC	LQFP176
R5F564MFDGFP		R5F564MFDGFB		R5F564MFDGFC	
R5F564MFGGFP		R5F564MFGGFB		R5F564MFGGFC	
R5F564MFHGFP		R5F564MFHGFB		R5F564MFHGFC	
R5F564MGCGFP		R5F564MGCGFB		R5F564MGCGFC	
R5F564MGDGFP		R5F564MGDGFB		R5F564MGDGFC	
R5F564MGGGFP		R5F564MGGGFB		R5F564MGGGFC	
R5F564MGHGFP		R5F564MGHGFB		R5F564MGHGFC	
R5F564MJCGFP		R5F564MJCGFB		R5F564MJCGFC	
R5F564MJDGFP		R5F564MJDGFB		R5F564MJDGFC	
R5F564MJGGFP		R5F564MJGGFB		R5F564MJGGFC	
R5F564MJHGFP		R5F564MJHGFB		R5F564MJHGFC	
R5F564MLCGFP		R5F564MLCGFB		R5F564MLCGFC	
R5F564MLDGFP		R5F564MLDGFB		R5F564MLDGFC	
R5F564MLGGFP		R5F564MLGGFB		R5F564MLGGFC	
R5F564MLHGFP		R5F564MLHGFB		R5F564MLHGFC	

表 4.3 対象製品型名 (RX71M グループ)

対象製品型名	パッケージ	対象製品型名	パッケージ	対象製品型名	パッケージ
R5F571MFCGFP	LQFP100	R5F571MFCGFB	LQFP144	R5F571MFCGFC	LQFP176
R5F571MFDGFP		R5F571MFDGFB		R5F571MFDGFC	
R5F571MFGGFP		R5F571MFGGFB		R5F571MFGGFC	
R5F571MFHGFP		R5F571MFHGFB		R5F571MFHGFC	
R5F571MGCGFP		R5F571MGCGFB		R5F571MGCGFC	
R5F571MGDGFP		R5F571MGDGFB		R5F571MGDGFC	
R5F571MGGGFP		R5F571MGGGFB		R5F571MGGGFC	
R5F571MGHGFP		R5F571MGHGFB		R5F571MGHGFC	
R5F571MJCGFP		R5F571MJCGFB		R5F571MJCGFC	
R5F571MJDGFP		R5F571MJDGFB		R5F571MJDGFC	
R5F571MJGGFP		R5F571MJGGFB		R5F571MJGGFC	
R5F571MJHGFP		R5F571MJHGFB		R5F571MJHGFC	
R5F571MLCGFP		R5F571MLCGFB		R5F571MLCGFC	
R5F571MLDGFP		R5F571MLDGFB		R5F571MLDGFC	
R5F571MLGGFP		R5F571MLGGFB		R5F571MLGGFC	
R5F571MLHGFP		R5F571MLHGFB		R5F571MLHGFC	

5. 参考ドキュメント

信頼性ハンドブック Rev. 2.50 (R51ZZ0001JJ0250) 2017.1

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.09.21	—	初版発行
1.10	2020.10.06	P10	温度プロファイルに事例 8 追加、ケース 2 事例 5 誤記修正(5年→2.5年)
1.20	2024.09.02	P3 P8 P9	参照先の URL を変更 「表 3.3 RX64M 消費電流内訳」更新 「表 3.4 RX71M 消費電流内訳」更新

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が異なる製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。